

第 16 回 有機/無機接合研究委員会

日時：2023 年 3 月 15 日（水）13:00～16:00

場所：慶應義塾大学 矢上キャンパス（神奈川県横浜市）

プログラム

司会 朝桐 智（(株) 東芝）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『簡便性と接着機能を両立するフィルム型接着剤 WelQuick の特徴と機能』（40 分）

..... ○高橋 信行（(株)レゾナック）

13:50～14:30

『塩害環境での樹脂材料のインピーダンスの変化』（40 分）

.....○堀江 俊男（(株)豊田中央研究所）

14:30～14:40 休憩

司会 井上 雅博（群馬大学）

14:40～15:20

『抵抗溶接技術を応用した金属と樹脂の接合装置』（40 分）

..... ○佐伯 修平（電元社トーア(株)）

15:20～16:00

『レーザを用いた熱可塑性樹脂と金属との接合法の開発』（40 分）

..... ○宮内 貴章、玉城 怜士、長谷川 慎一、上山 智之（(株)ダイヘン）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会